

**株式会社東京精密 2025 年度(2026 年 3 月期) 第 3 四半期 決算説明会
質疑応答 要約**

2026 年 2 月 6 日 開催

- 本資料は、上記日時に開催された 2025 年度(2026 年 3 月期)第 3 四半期決算説明会(Web 開催)の質疑応答の内容を、当社の判断で要約したものです。
- 本資料に記載されている情報は、決算説明会開催日時点での入手可能な情報をもとに、当社が合理的であると判断した一定の前提に基づいております。これらは、市況、競争状況、半導体業界ならびに自動車関連業界等の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。従って、今後の当社の実際の業績が、本資料に記載されている情報と大きく異なる場合がありますことをご承知おき下さい。
- なお、本資料では、半導体製造装置(または同セグメント)を「SPE」、精密計測機器(同左)を「計測」と表記します。

1. 2025 年度 10-12 月期の SPE 受注高は、会社想定と比べてどうだったのか。
 - 10-12 月期の SPE 受注高は概ね想定線だった。もとより 10-12 月期 < 1-3 月期の受注高をイメージしていた。
2. 10-12 月期の生成 AI を含む HPC 関連の受注高・売上高の詳細を聞きたい。
 - 10-12 月期の生成 AI を含む HPC 受注高は約 100 億円(前年同期比で概ね横ばい)、うちロジック向けが 9 割程度、残りが HBM 向けとなつた。
 - 同期間の生成 AI を含む HPC 売上高は概算で 80 億円台半ば(前年同期比で概ね倍増)、うちロジックと HBM 向けが半々だった。
3. プレゼンテーション補足資料 13 ページによれば、2026 年度下期の生成 AI を含む HPC 向け受注想定に 11 月予想からの変更がみられるが、その変化点を伺いたい。
 - 11 月時点では、生成 AI を含む HPC 受注の見通しについて、ロジック向けが 6 割弱、HBM 向けが 4 割半ばという想定だったが、今回ロジックが 7 割弱、HBM が 3 割半ばというような比率になるという想定へ変更した。
 - HBM は 7-9 月期に大きな受注が入っており、10-12 月期はその反動が出てい る。もっとも、1-3 月期は再度 HBM 向け案件の増加を想定している。
 - 2025 年度下期の生成 AI を含む HPC の受注見通し全体が 11 月予想から引き上 がつたこともあり、同期間の SPE 全体の受注高見通しを前回見通しから軽微に引 き上げている。
4. 会社は 2025 年 12 月にアドバンテストとダイレルプローバの共同開発に関するリリースを行っている。事業機会や想定市場規模に関してコメントが欲しい。
 - 想定市場規模に関する定量的なコメントは控える。
 - 今後、PLP が普及してくると、チップサイズが大きくなり、テスト機器としてダ

イレベルプローバの事業機会が増えることは間違いない、相応の市場規模になると考えている。

5. 2026 年度の売上高、利益の目線に関してコメントをいただきたい。

- 現在進めている 2025 年度-2027 年度中期経営計画の 2 年目となる 2026 年度は、定量目標を掲げる売上高・営業利益に近い水準の業績を達成できると考えている。現時点では SPE で 1,400 億円以上、計測で 450 億円を狙う事業環境になると感じている。
- その根拠として、①生成 AI を含む HPC (ロジック・HBM とも)は今後も成長が見込ること、②エッジ AI 向けの ASIC や汎用 DRAM の事業機会が期待できること、③汎用 NAND フラッシュ向けの投資が期待できること、④中国でのハイエンド半導体向けの事業機会を期待できることである。
- また、期待値として、①Hybrid Bonding 向けグラインダの事業機会(2026 年度は下期に受注高への貢献を想定している)、② PLP(現在は規格が統一されておらず、様々な技術要求がある状況)、③シリコンフォトニクス、④12 インチ SiC(現時点では基板評価の段階)などが成長機会になりえる。
- 利益面では、①当社の原価低減活動で足許の購入部材価格・外注加工費・運送費等の上昇をそれで相殺できない状態が続いているが、これらの上昇に一服感が出ていること、②付加価値の高い高精度温度制御機能を付加したプローバ売上構成比の拡大、③同様に付加価値の高剛性・高性能なグラインダ(HRG シリーズ)売上構成比の拡大、などを通じて改善してゆくと考えている。
- よって 2026 年度は、営業利益率でも中期経営計画の定量目標である全社 24% の水準をねらっていきたいと考えている。

6. 前段の利益目標に対して、蓋然性を確認できるコメントが欲しい。また、この 1-3 月期に一定の利益率改善が見込めるかどうかを確認したい。

- 1-3 月期の利益率は、10-12 月期比で確実に改善する。
- また、高付加価値の HBM 向け案件(7-9 月期に受注を獲得)は、この 1-3 月期と 4-6 月期に順次売上高が計上される計画なので、利益率へ一定の効果がみられる可能性がある。

7. 会社は、NAND フラッシュメモリ向け Hybrid Bonding 用グラインダの事業機会を示しているが、現時点で想定されるタイミングや市場規模のイメージを聞きたい。

- 11 月説明会時点での見方から大きな変更は無い。
- 複数の候補顧客に評価機を出荷しているが、評価基準を満足し、売上高を認識したものがある。今後は、試作量産のフェーズに入ると考えられ、それを加味する

と、短期的には数台/社、2027年度-2028年度にかけて、年間数十台の規模に増えると想定している。

8. プローバの高精度温度制御の必要性が高まっていると理解している。外部の者が、会社のプローバの市況の改善を確認できるとしたら、どういうタイミングになるか。

- 現時点では既に市況は改善傾向にあると考える。例えば、足許のHBM向けプローバは主にHBM3EならびにHBM4向けであるが、いずれも高精度温度制御が必須であるし、HBM4E~5でも一段高い温度制御の要求が来るであろう。HBM技術革新において、少なくともテスト工程では高精度な温度制御要求が高まるので、プローバの需要が拡大することは間違いないと思っている。
- また、足許では、HBM案件が2026年度上期に向け増加する基調を想定している。更にHBM4E~5に向けた引合いが発生するタイミングが来たら、外部からも見えやすい変化がみられるかもしれない。

以上